

The 5th International Symposium on
the New Frontiers of Thermal Studies of Materials

Registration Form

Name: _____

お名前（日本語でもお書きください）： _____

Title: _____

Affiliation: _____

ご所属（日本語でもお書きください）： _____

Address: _____

TEL: _____

FAX: _____

E-mail: _____

I plan to attend the symposium.

I plan to present a paper.

Title of the paper: _____

Author(s): _____

I plan to attend the symposium Banquet held on October 28.

Please return by e-mail to

Professor Hitoshi Kawaji, Chairman

E-mail: sympo@thermo.msl.titech.ac.jp

Materials and Structures Laboratory, Tokyo Institute of Technology

Mailbox: R3-8, 4259 Nagatsuta-cho, Midori-ku, Yokohama, 226-8503 Japan

参加費振込先

（参加費：一般 20,000 円，学生 5,000 円，懇親会費：一般 6,000 円，学生 3,000 円

（予約終了後、参加費：一般 30,000 円，学生 6,000 円，懇親会費：一般 8,000 円，学生 4,000 円）

みずほ銀行 青葉台支店 普通口座 2210733

第 5 回熱国際シンポジウム（ダイ 5 カイネツコクサイシンポジウム）